

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 券商策略会、电话会议
参与单位名称	华创证券（8月20日） 嘉实基金（8月20日） 鹏华基金（8月20日） 招商基金（8月20日） 睿扬资管（8月20日） 长江资管（8月20日） 盘京投资（8月20日） 申万宏源证券（8月20日） 泮谊投资（8月20日） 平安基金（8月20日） 华泰证券（8月20日） 喜世润投资管理（8月20日） 歌汝私募基金（8月20日） 国证资管（8月20日） 交银施罗德基金（8月20日） 华源电子（8月21日） 中海基金（8月21日） 嘉实基金（8月21日）

	<p>长江资管（8月21日）</p> <p>长信基金（8月21日）</p> <p>农银汇理基金（8月21日）</p> <p>中邮电子（8月21日）</p> <p>长江资管（8月21日）</p> <p>安联基金（8月21日）</p> <p>南方基金（8月21日）</p> <p>中信建投（8月25日）</p> <p>华商基金（8月25日）</p> <p>华泰证券（8月26日）</p> <p>建信基金（8月26日）</p> <p>兴全基金（8月26日）</p> <p>太保资产（8月26日）</p> <p>浦银安盛基金（8月27日）</p> <p>永赢基金（8月27日）</p> <p>华福证券策略会（8月27日）</p> <p>华夏久盈资管（8月28日）</p> <p>东方财富证券（8月28日）</p> <p>平安养老保险（8月28日）</p> <p>海富通基金（8月29日）</p> <p>平安基金（8月29日）</p> <p>华夏基金（8月29日）</p> <p>东吴证券策略会（8月29日）</p>
时间	2025年8月20日—8月29日
地点	公司会议室、深圳、上海
上市公司接待人员姓名	<p>副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东</p> <p>证券事务代表：周鸳鸯</p>

投资者关系活动
主要内容介绍

一、公司 2025 年上半年经营情况

2025 年以来，公司紧抓 AI 服务器高多层板需求增长和技术难度提升的双重需求，并进一步增强汽车电子、消费电子多层板及 HDI 板加工设备的竞争力，加上公司应用于高速 PCB、类载板及先进封装领域的新型激光加工方案获得下游客户青睐，公司订单取得显著增长，2025 年上半年实现营业收入 238,183.32 万元，较去年同期大幅增长 52.26%，归属上市公司股东的净利润 26,327.17 万元，较去年同期增长 83.82%。

二、PCB 行业发展趋势

2025 年以来，国内 DeepSeek 开源大模型引发 AI 加速应用，国内外云解决方案提供商持续提升算力中心投入，AI 算力数据中心服务器、交换机、光模块等终端需求延续强劲态势，PCB 产业直接受益，以高多层板为主的细分市场的需求快速攀升，促进下游 PCB 企业投资力度加大。行业知名研究机构 Prismark 预估 2025 年 PCB 产业营收和产量分别成长 7.6% 和 7.8%，其中与 AI 服务器和交换机相关的高多层板及 HDI 板增长最为强劲，2024-2029 年产能复合增长率分别高达 22.1% 和 17.7%。

PCB 作为电子产品之母，是所有电子系统的中枢神经系统，支撑电子信息产业快速发展，是各行业技术进步越来越重要的载体。从长期来看，AI 算力产业链从训练需求逐步渗透到推理需求，对 800G 交换机、GPGPU 服务器、ASIC 服务器的等算力基础设施进一步增加，AI PCB 成为行业发展的最大增长点，包含高多层板、高多层 HDI 板、大尺寸先进封装载板、类载板等产能需求旺盛，促进专用加工设备市场的规模不断扩大；另一方面，受电动化、智能化驱动，汽车相关电子零部件成本占比大幅攀升，拉动整车的 PCB 需求量增加，加上消费电子、工业控制等领域终端拉升库存意愿增长，共同推动 PCB 产业长期向好发展。据 Prismark 预测，2024-2029 年 PCB 行业营收复合增长率预计可达 5.2%，全球及国内 PCB 产业规模在 2029 年将分别达到近千亿美元及五百亿美元。

三、高多层板市场情况

在高多层板市场，随着数据量的急剧增长，AI 服务器、高速交换机等终端单通道 112/224Gbps SerDes 设计被广泛采用，需要更高层数、更高密度的高速多层板来承载，为确保高速 PCB 的信号

完整性，对孔、线路及成品品质提出更高要求。

在钻孔方面，无论高速材料的变更，还是厚径比的上升，都导致机械钻孔机效率大幅降低，加工同样面积的 AI PCB 产品所需设备数量大幅增加；而信号完整的提高，背钻孔数提升的同时加工精度要求更高，对更高技术附加值的 CCD 六轴独立机械钻孔机的需求量更多。除公司原有优势产品一经典双龙门设计机械钻孔机持续获得客户复购外，新开发的具有 3D 背钻功能的钻测一体化 CCD 六轴独立机械钻孔机，可实现超短残桩及超高位置精度的背钻孔加工，也已获得行业终端客户的认证及多家高多层板龙头企业的大批量采购；而针对高多层 HDI 板的加工需求，除以上提到的机械钻孔机产品需求外，还需要更多的激光钻孔机来满足多阶堆叠盲孔或深盲孔加工，公司研发的高功率及能量实时监测的 CO₂ 激光钻孔机可实现大孔径及跨层盲孔的高品质加工。

除钻孔工序外，高速高多层板对线路的对准度及线路公差要求非常高，公司提供高性能激光直接成像系统，可满足阻抗±8%公差要求下的层间对准度及线宽极差要求；而超大点数通用测试机、CCD 高精度四线测试机及最小分辨率 10μm 以下的光学检查设备，为 AI PCB 成品的高品质保驾护航。

公司相关设备方案不断进行优化，突破 AI 服务器产业链终端客户设计及 PCB 主力厂商生产的技术瓶颈，提供满足 AI 服务器等大厚板日益增加的高厚径比、更严格阻抗公差、更高信号完整性、更高电性能需求的高可靠性加工方案，并在产能和交付方面具有极大的区位优势，助力下游客户快速扩大增长强劲的高多层板市场竞争力，已经取得行业诸多龙头客户的信赖。

四、HDI 市场情况

HDI 板应用日益广泛，AI 智能手机、AI PC、汽车电子、光模块等需求快速增加，且技术上从中低阶 HDI 到任意层 HDI 再提升至类载板，公司针对不同技术需求提供差异化解决方案。

在传统及任意层 HDI 市场，随着智能手机、汽车电子等功能的增加，HDI 板的特征尺寸进一步微缩，对专用设备加工性能及效率提出更高要求。公司持续升级四光束 CO₂ 激光钻孔机、高解析度激光直接成像系统、定位精度±5μm 高精测试机等产品性能，以满足该 HDI 产品特征参数不断微缩的技术要求，相关产品在国内品牌及 ODM 手机 HDI 产品应用上综合竞争力领先。另外，AI 智能手机、

	<p>800G⁺光模块等逐步采用类载板，带动了微小孔、槽及外形的高精度加工需求，公司提供新型激光加工方案，突破传统 CO₂ 激光热效应大的瓶颈，实现微小孔钻孔及超高精度外型的成型加工的高品质要求，为行业新兴应用提供新动力，已获得下游客户工艺认可及正式订单。</p> <p>随着公司个性定制化产品方案的相继推出及下游客户的广泛认可，有望进一步推动公司在 HDI 市场相关设备营收的快速增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 8 月 29 日